(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 12 月 4 日(04.12.2014)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2014/192631 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2014/063578

(22) 国際出願日: 2014 年 5 月 22 日(22.05.2014)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2013-115704 2013 年 5 月 31 日(31.05.2013) JP

(71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社 (MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.) [JP/JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美土代町７ Tokyo (JP).

(72) 発明者: 宇杉 真一(USUGI Shinichi); 〒1057117 東京都港区東新橋一丁目５番２号 三井化学株式会社内 Tokyo (JP). 五十嵐 康二 (IGARASHI Kouji); 〒4570801 愛知県名古屋市南区丹後通２－１ 三井化学東セロ株式会社内 Aichi (JP). 森本 哲光(MORIMOTO Akimitsu); 〒4570801 愛知県名古屋市南区丹後通２－１ 三井化学東セロ株式会社内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田７丁目９番２号 五反田ＴＧビル９階 Tokyo (JP).

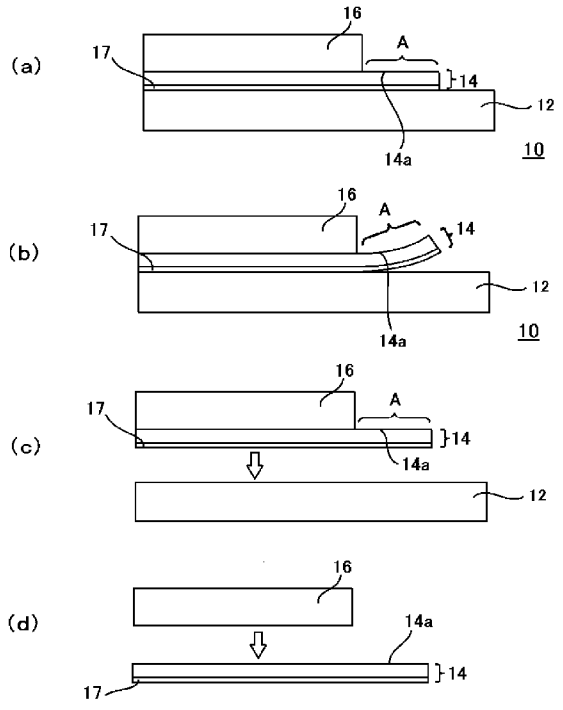
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) **Title**: ELECTRONIC MEMBER PEELING METHOD AND LAMINATED BODY

(54) 発明の名称 : 電子部材の剥離方法および積層体



(57) **Abstract**: This electronic member peeling method is a method for peeling an electronic member (16) from a laminated body (10) wherein the electronic member (16) is adhered on a supporting substrate (12) with an adhesive film (14) therebetween. The adhesive film (14) is provided with a self-peeling adhesive layer (17) on the supporting substrate (12) side, and is also provided with a region (A) where at least a part of a surface (14a) on the electronic member (16) side is exposed therefrom. The method includes: a step wherein energy is applied to the region (A), and an adhesive force between the supporting substrate (12) and the self-peeling adhesive layer (17) in the region (A) is reduced; a step wherein energy is further applied, and the supporting substrate (12) is removed by reducing the adhesive force between the supporting substrate (12) and the self-peeling adhesive layer (17) by having, as a starting point, the interface between the supporting substrate (12) and the self-peeling adhesive layer (17) in the region (A), said interface having reduced adhesive force; and a step of peeling the electronic member (16) by removing the electronic member (16) from the adhesive film (14).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2014/192631 A1

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

本発明の電子部材の剥離方法は、支持基板（１２）上に接着フィルム（１４）を介して電子部材（１６）が貼着された積層体（１０）から、電子部材（１６）を剥離する方法であって、接着フィルム（１４）は、支持基板（１２）側に自己剥離型接着層（１７）を備えるとともに、電子部材（１６）側の面（１４ａ）の少なくとも一部が露出した領域Ａを備え、領域Ａにエネルギーを付与し、領域Ａの支持基板（１２）と自己剥離型接着層（１７）との接着力を低下させる工程と、さらにエネルギーを付与し、接着力が低下した、領域Ａの支持基板（１２）と自己剥離型接着層（１７）との界面を起点として、支持基板（１２）と自己剥離型接着層（１７）の接着力を低下させて支持基板（１２）を除去する工程と、電子部材（１６）から接着フィルム（１４）を除去し、電子部材（１６）を剥離する工程と、を含む。